

# 数学与系统科学研究院

## 计算数学所学术报告

报告人: 周浩 博士

( 复旦大学微电子系 )

报告题目:

**3D 芯片热力分析**

邀请人: 崔涛 博士

报告时间: 2014 年 12 月 16 日(周二)

下午 14:30-15:30

报告地点: 数学院科技综合楼四层

401 教室

## 摘要:

三维堆叠芯片的设计方法, 可以获得高集成度、低功耗、低成本的芯片。但这种堆叠设计, 对于热量的传导, 温度的管理提出了挑战。报告将介绍利用并行有限元方法进行基于TSV的三维芯片的热应力分析。该方法具有良好的精度, 并行效率和可扩展性, 适宜进行大规模数值模拟。

**欢迎大家参加!**